

证券代码：688627

证券简称：精智达

深圳精智达技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他：券商策略会
参与单位	粤开资本、银河资本、国贸创领（上海）私募基金、常州金融投资集团、广东温氏投资、陕西省高新技术产业投资、四川璞信产融投资、中国北方工业、江西金控投资、第一创业证券、国泰租赁、吉富创业投资、深圳市康曼德资本、广东邦领投资、远致瑞信股权投资、上海杉玺投资、深圳前海辰星私募证券投资基金、深圳纽富斯投资、深圳市同心投资基金、湖南高新创业投资、四川新宏信资产、广东明道投资、光大理财、粤财基金、北京源峰私募基金、广州工控资本、深圳市前海船海私募股权基金、广东恒阔投资、广东省粤科金融集团、天壹紫腾资产、君联资本、中欧瑞博(香港)资产
时间	2026年6月5日
地点	公司会议室
接待人员姓名	董事会秘书：彭娟 董事：谢思遥
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司如何看待半导体测试需求市场？</p> <p>随着摩尔定律逐渐逼近极限，2.5D/3D 封装、Chiplet 等先进封装技术成为关键路径，芯片结构从平面走向立体，其复杂的互连结构与集成形态对测试设备的信号精度、多通道</p>

协同能力及系统兼容性提出更高要求。HBM 凭借高带宽优势已成为高性能计算和人工智能的重要解决方案，驱动测试设备向高精度、高并行测试能力方向迭代。设备架构复杂化及人工智能对高性能的需求共同推动半导体测试设备市场增长。根据 SEMI 预测，2025 年全球半导体测试设备销售额将增长 48.10%至 112 亿美元。同时，XR 及智能眼镜的快速发展亦驱动 MicroOLED/LED 等微显示技术加速产业化。另一方面，随着全球贸易摩擦加剧，我国半导体产业面临着供应链安全和技术突破的严峻挑战，高端半导体测试检测设备进口替代需求日益迫切。在此背景下，我国高端半导体测试检测设备国产化进程有望进一步加速，本土厂商也将受益。

二、请介绍公司在半导体领域的战略规划方向。

依托多年在半导体存储测试领域的深耕积累和自主创新，产品线已覆盖半导体存储器测试领域的关键测试设备和治具，主要产品包括晶圆测试设备、老化测试及修复设备、高速 FT 测试设备、MEMS 探针卡、老化治具板、FT 测试治具等，是国内少数实现半导体存储器测试设备全覆盖的厂商，已于部分产线成功取代国外供应商成为相关产品主要供应商，实现重要生产环节自主可控。为了更好地满足客户对高端半导体测试设备日益增长的市场需求，接下来，公司将持续提升高端半导体测试设备的产业化能力，进一步提升“设备平台+解决方案”的综合服务能力，巩固并提升公司在半导体测试设备领域的竞争力。

三、请介绍公司的产能管理情况。

近年来，受益于下游市场需求旺盛、公司技术迭代与应用场景的不断拓展，公司半导体测试设备业务呈现快速增长趋势。对此，公司将在深圳市龙华区投资建设高标准产业化

	<p>智造基地，在全力保障当前产品交付的基础上，进一步提升规模化、现代化、自动化的先进制造能力，以便更加敏捷地响应国内客户在技术升级与产能爬坡过程中的设备需求。此外，公司本次在上海设立研发中心，将充分依托区域客户资源、技术储备和人才优势，与客户形成“协同研发-迭代验证-规模量产”的闭环，精准满足高端算力芯片测试设备和 HBM 测试设备等高端半导体测试设备广阔的市场需求。</p> <p style="text-align: center;">四、请问公司如何构建竞争壁垒？</p> <p>半导体测试检测设备行业具有技术壁垒高、资金投入大、与下游产业链协同性强的显著特征。下游芯片企业对设备的可靠性、稳定性要求极为严格。设备投入产线后需经过长期、大规模的量产验证，方能获得客户认可。这一验证周期不仅关乎客户信任的建立，更是对设备极限性能的检验：设备必须在海量芯片的测试过程中保持极低的误判率，任何偏差均可能显著增加半导体厂商的测试成本。公司以平台化能力为核心支撑，依托五大核心产品矩阵、延伸战略生态，实现高质量稳健增长，核心技术壁垒持续强化，市场竞争力与产业协同能力显著提升。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026年6月9日</p>